# (100) 配向 Grain-Boundary-Free Si 薄膜のレーザ結晶化機構

## Growth Kinetics of the Laser Crystallized (100)-Oriented Grain-Boundary-Free Si Film

## Sasaki Consulting<sup>1</sup>、奈良先端大<sup>2</sup>

<sup>O</sup>佐々木 伸夫  ${}^{1,2}$ 、(D)Muhammad Arif<sup>2</sup>、(M)高山 智之  ${}^{2}$ 、浦岡 行治  ${}^{2}$ 

#### Sasaki Consulting<sup>1</sup> and NAIST<sup>2</sup>

### <sup>O</sup>Nobuo Sasaki <sup>1, 2</sup>, Muhammad Arif <sup>2</sup>, Satoshi Takayama<sup>2</sup>, and Yukiharu Uraoka<sup>2</sup>,

#### E-mail: sassasaki@yahoo.co.jp

(背景と課題) 絶縁膜上の融液からのレーザ結晶化は、室温基板上での高移動度 Si-TFT の実現を可能とし、monolithic 三次元 IC や、system FPD への応用が期待される。パルス ELA レーザ結晶化 に対し CW(Continuous Wave) レーザ結晶化では、より高移動度の TFT が容易に実現できる[1]。 単結晶に近い膜を得るには結晶粒界制御よりも、結晶方位制御が一層重要である。しかし、従来の CW レーザラテラル結晶化(CLC)では、結晶粒が約 3  $\mu$ m×20  $\mu$ m と小さいだけでなく、結晶 粒方位の制御が不能だった[1]。反射防止膜法[2]や beam shaping 法[3]では、狭い 4~10  $\mu$ m 幅 のストライプ状ながら、スキャン中央から両端部への温度分布制御で、粒界を両端へ掃き出し た結晶が得られたが、方位が変動した[2,3]。結晶粒界が存在しなくても 100  $\mu$ m のスキャンで 連続的な方位変化が見られている。また、これらの方法は原理的に結晶化幅の拡大が困難であ る。一方、重ね CW レーザスキャンでは、3~5 回の重ねで(100)優先配向が得られるが、ランダ ムな結晶粒界の残留が見られる[4-6]。我々は、(100)配向を持ち、結晶粒界を含まない領域を 拡大するには、時間的に極めて安定なレーザを用い、beam を長軸方向に極めて一様にすれば、

むしろ単純な線状 beam による 1 回スキャンが適しているこ とを見出した。この技術で、溶融石英上[5,7-10]、およびガ ラス上[11]で、(100)に配向した無粒界薄膜の成長に成功し、 ポリイミド膜上でも(100)成長に成功した[12]。試料表面垂 直方向およびスキャン方向に<100>方位を保ちつつ、100~ 200 $\mu$ m 幅で、1mm 以上に、結晶粒界を含まない巨大結晶粒を スキャンが続く限り連続して成長させることができた[10]。



これらの結晶成長 kinetics を議論する。なお、高パワー域でしばしば観察される {211} 結晶 粒は、Si 結晶が成長した後での deformation twinning が原因なので[9]、ここでは触れない。 (モデル) 粒状結晶からスキャン方向に<100>である結晶への相転移、およびさらにパワーを上 げたときのスキャン方向結晶面の<100>から<110>への変化を、等温度面の傾きから統一的に説 明する。固液界面は界面エネルギーが等方的と考えれば平坦面で近似できる。固液界面に対し て、等温度面が傾いているときには、固液界面を等温度面と平行にしようとする偶力が働き[8]、 固液界面は等温度面と常に平行になろうとする。一方、結晶異方性のため固液界面は原子層レ ベルでは、{111}ファセット構造を持つ。この{111}ファセット構造の幾何学的変化によりファ セットを持つ固液界面の平均の傾きは、変化し得る。等方結晶の温度分布モデルによる等温度 面の傾きのパワー依存性と、ファセット構造の変化による固液界面の平均の傾きの変化を組み 合わせることで、上記の面内結晶方位変化のパワー依存性が説明される。

#### (参考文献)

- [1] A. Hara et al., Japan. J. Appl. Phys., 43, 1269 (2004).
- [2] K. Sugahara et al., J. Appl. Phys., 62, 4178 (1987).
- [3] W. Yeh et al., Japan. J. Appl. Phys., 59, 071008 (2020).
- [4] P. C. van der Wilt et al., Proc. SPIE, 6106, 61060B (2006).
- [5] N. Sasaki et al., SID (San Francisco, May 22-27, 2016) Dig. Tech. Papers, p.1317 (2016).
- [6] T. T. Nguyen et al., Appl. Phys. Express, 10, 056501 (2017).
- [7] N. Sasaki et al., Thin Solid Films, 631, p.112 (2017).
- [8] N. Sasaki et al., Appl. Phys. Express, 12, 055508 (2019).
- [9] N. Sasaki et al., Japan. J. Appl. Physics, 58, SBBJ02 (2019).
- [10] M. Arif et al., Thin Solid Films, 708, 138127 (2020).
- [11] N. Sasaki et al., IEEE S3S Conference (San Jose, Oct. 14-17, 2019) Paper 6.02.
- [12] N. Sasaki et al., J. Electronic Materials, 50, 2974 (2021).